

2023-2029年中国IC先进 封装产业发展现状与投资战略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国IC先进封装产业发展现状与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202309/410211.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国IC先进封装产业发展现状与投资战略报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：第一章 IC封装产业相关概述 第一节 IC封装涵盖 第二节 IC封装类型阐述 一、SOP封装 二、QFP与LQFP封装 三、FBGA 四、TEBGA 五、FC-BGA 六、WLCSP 第三节 明日之星——TSV封装 一、TSV简介 二、TSV与SoC 三、TSV产业与市场 第二章 世界IC封装产业运行态势分析 第一节 世界IC封装业运行环境浅析 一、经济大环境及影响分析 二、集成电路产业运行总况 第二节 世界IC封装运行现状综述分析 一、IC封装产业热点聚焦 二、IC封装业新技术应用情况 三、IC封装基板市场分析 四、IC封装材料市场发展 五、IC封装生产企业向中国转移 第三节 世界IC封装重点企业运行分析 一、英特尔（Intel） 二、IBM 三、超微 四、英飞凌（Infineon） 第四节 世界IC封装业趋势探析 第三章 中国IC封装行业市场运行环境解析 第一节 中国宏观经济环境分析 一、国民经济增长 二、中国居民消费价格指数 三、工业生产运行情况 四、房地产业投资情况 五、中国制造业采购经理指数 第二节 中国IC封装市场政策环境分析 一、电子产业振兴规划解读 二、IC封装标准 三、内需拉动业，IC业政策与整合是关键 四、相关行业政策及对IC封装产业的影响 第三节 中国IC封装市场技术环境分析 一、高端IC封装技术 二、中高端IC封装技术有所突破 三、IC封装基板技术分析 第四章 中国IC封装产业整体运行新形势透析 第一节 中国IC封装产业动态聚焦 一、半导体封装基板项目落户无锡 二、国内IC封装及IC基板用硅微粉实施产业化 三、中国IC代工封装等已进入国际排行榜 第二节 中国IC封装产业现状综述 一、我国IC封装业正向中高端迈进 二、探密中国IC封装产业变局 三、中国正成为IC封装中心 四、IC封装年产能分析 第三节 中国IC封装产业差距分析 一、工艺技术 二、质量管理 三、成本控制 第四节 中国IC封装产思考 一、技术上：引进和创新相结合 二、人才上：引进和培养相结合 三、资金上：资本运作是主要途径 第五章 中国IC封装技术研究 第一节 中国IC封装技术热点聚焦 一、封装测试技术新革命来临 二、芯片封装厂封装技术或转向铜键合 三、RFID电子标签的封装形式和封装工艺 四、降低封装成本 提升工艺水平措施 第二节 高端IC封装技术 一、IC制造技术 二、TAB Potting System 三、BGA,CSP Ball Mounting System 四、Flip-Chip Bonding System 五、TAB Marking System 六、TFT-LCD Cell Bonding System 第六章 中国IC封装测试领域深度剖析 第一节 中国IC封装测试业运行总况 一、IC封装测试业外资独占鳌头 二、测试企业布局力度将加大 三、中高档封测产品占比将逐年提升 四、应对知识产权、环保考验 第二节 新型封装测试技术 一

、MCM(MCP)技术 二、SiP封装测试技术 三、MEMS技术 四、BCC封装技术 五、Flash Memory(TSOP)塑封技术 六、多种无铅化塑封技术 七、汽车电子电路封装测试技术 八、Strip Test(条式/框架测试)技术 九、铜线键合技术 第七章 中国IC封装产业主要数据监测分析 (4053) 第一节 中国IC封装行业规模分析 一、企业数量增长分析 二、从业人数增长分析 三、资产规模增长分析 四、销售规模增长分析 第二节 中国IC封装行业应收账款情况分析 第三节 中国IC封装行业产值分析 一、产成品增长分析 二、工业销售产值分析 第四节 中国IC封装行业成本费用分析 一、销售成本分析 二、费用分析 第五节 中国IC封装行业盈利能力分析 一、主要盈利指标分析 二、主要盈利能力指标分析 第八章 中国IC封装产业运行新形势透析 第一节 中国IC封装产业运行综述 一、大陆IC封装企业的分布及其特点 二、IC封装向高端技术迈一步 三、形成封装及自主品牌终端产业链 第二节 中国IC封装产业变局分析 一、IC封装业稳步发展,但产值比重有所下降 二、产业格局外企主导,行业竞争日益激烈 三、封装技术更新加快,国内水平显著提高 第三节 金融危机对中国IC封装业影响及应对分析 一、金融危机对封装业冲击较大 二、创新使IC封装企业成功渡过危机 第四节 中国IC封装业面临的挑战分析 一、低档产品封装产能过剩,高端产品的封装刚刚起步 二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战 三、我国IC的相关行业配套能力差,也对封装业造成不利影响 四、技术相对滞后 五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足 第五节 对发展我国IC封装业的思考 第九章 中国IC封装细分市场运行分析 第一节 手机IC封装市场 第二节 手机基频封装 一、手机基频产业 二、手机基频封装 第三节 智能手机处理器产业与封装 第四节 手机射频IC 一、手机射频IC市场 二、手机射频IC产业 三、4G时代手机射频IC封装 第五节 PC领域先进封装 一、DRAM产业近况 二、DRAM封装 三、NAND闪存产业现状 四、NAND闪存封装发展 五、CPU GPU和南北桥芯片组 第十章 中国封装用材料运行分析 第一节 金线 第二节 IC载板 第十一章 中国IC封装产业竞争新格局探析 第一节 中国IC封装竞争总况 一、封装市场竞争激烈 二、倒装芯片封装更具竞争力 三、封装低端市场竞争力加强 四、IC封装技术竞争力分析 五、外资加大中国市场布局对产业竞争的影响 第二节 中国IC封装产业集中度分析 一、市场集中度分析 二、生产企业集中度分析 第三节 中国IC封装竞争趋势分析 第十二章 中国半导体(集成电路)封装重点企业运营财务状况分析 第一节 长电科技(600584) 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第二节 深圳赛意法微电子有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第三节 南通富士通微电子股份有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第四节 中芯国际集成电路制

造(天津)有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第五节 英特尔产品(成都)有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第六节 无锡菱光科技有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第七节 恒宝股份有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第八节 南京汉德森科技股份有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第九节 深圳市比亚迪微电子股份有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第十节 常州市欧密格电子科技有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第十三章 2018年中国芯片封装重点企业关键性财务指标分析 第一节 安靠封装测试(上海)有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第二节 沛顿科技(深圳)有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第三节 淄博凯胜电子技术有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第四节 河南鼎润科技实业有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第五节 盟事达智能卡技术(深圳)有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第十四章 中国封装材料企业运营竞争性指标分析 第一节 汉高华威电子有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第二节 厦门惠利泰化工有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第三节 福建易而美光电材料有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第四节 无锡创达电子有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第五节 鼎贞(厦门)系统集成有限公司 一、企业概况 二、企业

主要经济指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析 第六节 无锡市江达精细化工有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济
指标分析 三、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企
业成长能力分析 第七节 陕西华电材料总公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三
、企业盈利能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析
第八节 无锡嘉联电子材料有限公司 一、企业概况 二、企业主要经济指标分析 三、企业盈利
能力分析 四、企业偿债能力分析 五、企业运营能力分析 六、企业成长能力分析 第十五章
中国IC封装业前景预测分析 第一节 中国IC封装业前景预测 一、环氧树脂在电子封装应用方
面前景开阔 二、太阳能光伏行业对封装材料需求前景光明 第二节 中国IC封装产业新趋势探
析 一、新型的封装发展趋势 二、集成电路封装的发展趋势 三、IC封装技术发展趋势 四
、IC封装材料市场发展趋势 五、半导体IC封装技术发展方向 第三节 中国IC封装市场前景预
测 第四节 中国IC封装市场盈利预测 第十六章 中国IC封装行业发展预测及风险分析 第一节
中国IC封装行业供需预测 一、市场规模预测 二、生产预测 三、需求量预测 第二节 中国IC
封装行业投资机会分析 第三节 中国IC封装行业风险分析 一、市场供需风险 二、经营管理风
险 三、政策风险 四、其它风险 第四节 中国IC封装行业发展战略及策略建议 一、对行业发
展形势的总体判断 二、发展战略及市场策略分析 略••••完整报告请咨询客
服

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202309/410211.html>